

Compression Molding System

Model CPM2250

Coming soon

**Compression molding system
for large size PLP molding to meet industry needs**

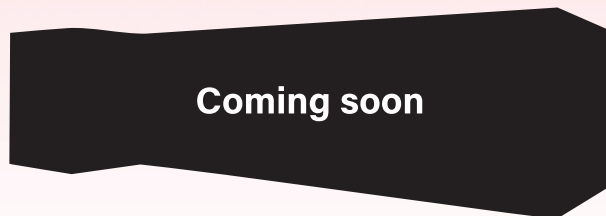
实现满足行业需求的大尺寸PLP成型的压缩模塑设备

产品信息



中文

- 可实现最大625mm×620mm超大尺寸面板级的自动成型
- 通过高成型压力，实现窄间隙MUF工艺对应
- 支持液态树脂和Full mold塑封
- 采用最合适的成形技术进行大尺寸面板级封装
- 应用自研的Cavity Down成型方式实现超大尺寸面板级封装的高品质化
- 通过颗粒树脂的均匀铺撒来实现成型品质的安定化
- 可通过增设或减少模组的方式灵活应对产能变化



SPECIFICATION

Items		Unit	Description			
机型		—	CPM2250			
设备区分		—	Manual	Semi-Auto	Full-Auto	
面板·晶圆类型		—	面板·晶圆			
面板·晶圆尺寸	面板	mm	625 × 620 (Max.)			
	晶圆	mm	φ 450 (Max.)	—	—	
树脂		—	颗粒·液态			
机械时间		sec	—	—	Approximately 75	
外形尺寸	模组数量	module	1	1	1	2
	宽度	mm	2,680	4,395	6,035	7,685
	纵深	mm	2,670	2,670	3,750	3,750
	高度	mm	2,310	2,310	2,310	2,310
重量		ton	14.8	19.7	22.2	35.0
每模成型面板数量		workpiece	1	1	1	2
料盒放置空间		—	—	—	FOUP Input/Output stage : 1 cassette each In/Out stage : Panel 1 by 1	
合模压力		kN/(tf)	49.0—2,451.0/5.0—250.0			
合模速度		mm/sec	70 (Max.)			
品种切换方式		—	—	采用KIT更换方式		
使用分离膜的宽度		mm	740 (Max.)			

- 以上数据为本公司标准机型时的规格
- 以上规格根据实际需要可能有改良变更的可能
- 如有其他特殊规格要求，另行协商
- 外形尺寸为颗粒树脂规格的产品



[东和半导体设备（上海）有限公司]

中国上海市普陀区凯旋北路1188号环球港B座20A

TEL 021-6888-6860

[Overseas Sales Contacts]

■ Japan / Headquarters

· TOWA Corporation

■ China

· TOWA (Shanghai) Co., Ltd.
· Hechuang Semiconductor Equipment (Shenzhen) Co., Ltd.
· TOWA Taiwan Co., Ltd.

■ Korea

· TOWA Korea Co., Ltd.

■ Singapore

· TOWA Asia-Pacific Pte. Ltd.

■ Malaysia

· TOWA Malaysia Sales & Services Sdn. Bhd.

■ Thailand

· TOWA THAI COMPANY LIMITED

■ Philippines

· TOWA Semiconductor Equipment Philippines Corp.

■ India

· TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED

■ Germany

· TOWA Europe GmbH

■ Netherlands

· TOWA Europe B.V.

■ the United States

· TOWA USA Corporation



TOWA (本公司商标),  是TOWA株式会社的商标或注册商标。

[Website] [Inquiry contact]

20260401-001-HQ